

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2018年5月3日(03.05.2018)



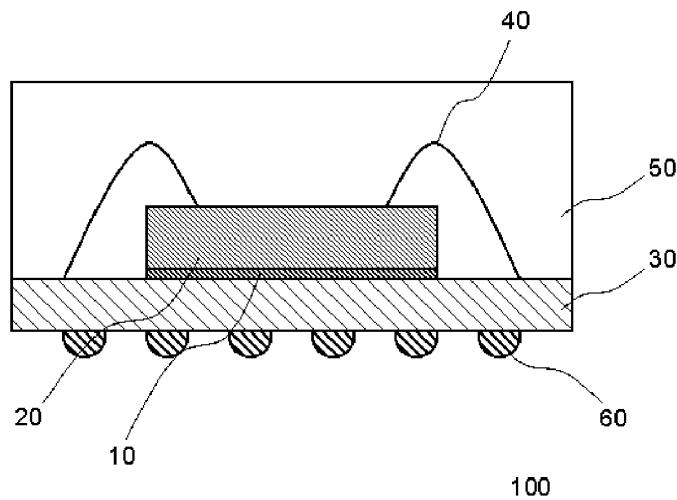
(10) 国際公開番号

WO 2018/079533 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 101/00 (2006.01) *C08L 61/06* (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01) *H01L 21/52* (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01) *H01L 23/36* (2006.01)
C08K 3/28 (2006.01) *H05K 7/20* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2017/038314
- (22) 国際出願日: 2017年10月24日(24.10.2017)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2016-213663 2016年10月31日(31.10.2016) JP
- (71) 出願人: 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP];
〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 牧原 康二 (MAKIHARA Koji);
〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号
住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI Shinji); 〒1410031
東京都品川区西五反田7丁目9番2号 K
DX五反田ビル9階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: THERMALLY CONDUCTIVE PASTE AND ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称: 熱伝導性ペーストおよび電子装置



(57) Abstract: This thermally conductive paste includes a thermosetting resin, a curing agent, an acrylic compound, and a thermally conductive filler. At least either the thermosetting resin or the curing agent includes a resin having a biphenyl skeleton. The acrylic compound includes a (meth) acrylic monomer.

(57) 要約: 本発明の熱伝導性ペーストは、熱硬化性樹脂と、硬化剤と、アクリル化合物と、熱伝導性フィラーと、を含むものであって、熱硬化性樹脂および硬化剤の少なくとも一方が、ビフェニル骨格を有する樹脂を含み、アクリル化合物が、(メタ)アクリルモノマーを含むものである。

[続葉有]



WO 2018/079533 A1

SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))